
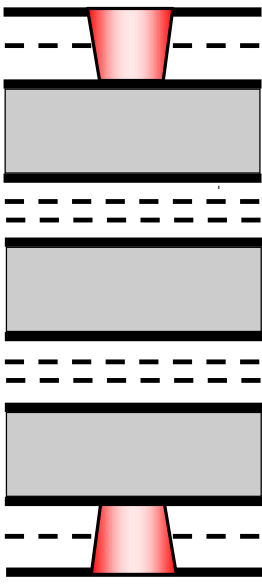


LAGENAUFBAU HDI (Standard)										
HDI08_1+6+1_1,20_35			8 - Lagen Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm							
WE-Artikel Nr.:		1 + 6 + 1								
KUNDE:										
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG	
KUNDE	WE							[µm]	[µm]	
	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12		
							1 x 1080	60		
	2				0,200 mm	35 µm		33		
							2 x 1080	200		
	3					35 µm		33		
							2 x 1080	124		
	4				0,200 mm	35 µm		33		
				2 x 1080	200					
	5		35 µm		33					
				2 x 1080	124					
	6	0,200 mm	35 µm		33					
				2 x 1080	200					
	7		35 µm		33					
				1 x 1080	60					
	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12					
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm					
					Gesamtdicke Material: 1190					
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)					
MATERIALDICKE:		<b>1,20</b>	+/-	0,09	mm	Datum:		Bearbeiter:		
DICKE über galv. Endoberfläche		1,29	+/-	0,12	mm					
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,35	+/-	0,14	mm					
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:				
Erstellt am			Geprüft am			Freigegeben am			Revision	
25.04.2006			04.05.2006			25.04.2006			00	
S. Keller			M.Kress			R. Schönholz			Seite: 3+	